

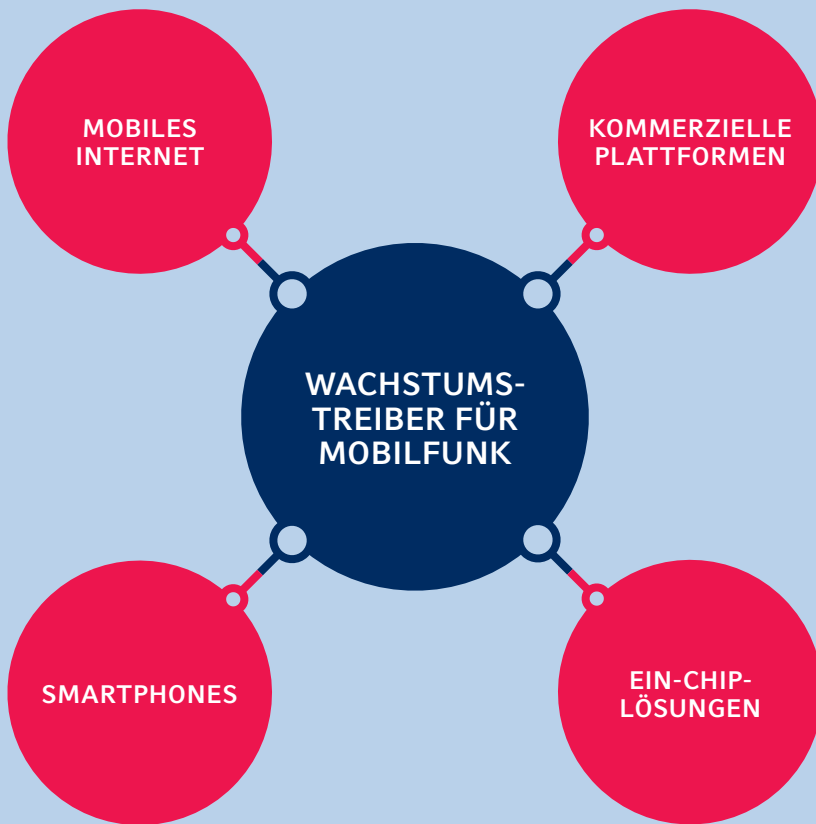


**AUTOMOBILELEKTRONIK  
INDUSTRIELEKTRONIK  
CHIPKARTEN UND  
SICHERHEITSLÖSUNGEN  
MOBILFUNK  
BREITBANDZUGANG**



**VIJAY ANAND KRISHNA PRASAD**  
ANALYSIERT UND VERBESSERT DIE  
RECHENLEISTUNG UND DATENÜBER-  
TRAGUNGSRATEN ZUKÜNFTIGER  
MOBILFUNK-PLATTFORMEN. DERZEIT  
ARBEITET ER AN UNSEREN HSPA-  
PLATTFORMEN.





## Zielmarkt Mobilfunk

Mit Produkten für den Zielmarkt Mobilfunk erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2008 rund 20 Prozent der Umsätze aus fortgeführten Aktivitäten bei einer hohen einstelligen negativen Marge vor Zinsen und Steuern.

Infineon stellt nicht nur klassische Komponenten der Basisbandprozessoren, Hochfrequenz-Transceiver und Stromversorgungs-Managementchips her, sondern bietet auch komplette Plattformen inklusive Software-Lösungen, kundenspezifische Anpassungen und Interoperabilitätstests an. Die großen Mobilfunkhersteller wie zum Beispiel Nokia setzen zunehmend auf diese kommerziellen Plattformen und reduzieren in gleichem Maße die Eigenentwicklung. Infineon wurde inzwischen zum drittgrößten Lieferanten für solche Plattformen.

Die neue Division „Wireless Solutions“ profitiert zudem von folgenden zwei Trends:

- Computer und Mobiltelefon verschmelzen immer mehr zu einer Einheit. Laptops werden kleiner und beinhalten drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten; Mobiltelefone und PDAs werden immer leistungsfähiger. Eine neue Geräteklasse, die sogenannten Smartphones, entsteht. Die größten Wachstumschancen im mobilen Datengeschäft ergeben sich daher aus der mobilen Nutzung des Internets.
- Die internationale Penetrationsrate erreichte gegen Ende 2008 die Schwelle von 50 Prozent. Das bedeutet: Die eine Hälfte der Menschheit hat schon ein Handy – jetzt macht sich die Branche daran, die andere Hälfte zu erobern.

Nach Kamera- und GPS-Funktion kommt nun auch das Internet aufs Handy. Benutzerfreundliche Geräte mit hoher Bildschirmauflösung und leistungsfähigen Audio/Video-Komponenten eröffnen eine neue Dimension der mobilen Unterhaltung. Neben komplexen Software-Lösungen setzt das auch die Bereitstellung entsprechender Hardware, also leistungsfähiger Empfangs- und Sendekomponenten, voraus.

Die modernste Übertragungstechnologie HSDPA ist dabei ein Muss. Infineon liefert mit seiner Plattform XMM™60xx hierfür die in zwei entscheidenden Punkten überzeugende

### 09 MARKT- UND UNTERNEHMENS DATEN: MOBILFUNK

QUELLE: ISUPPLI, MÄRZ 2008



Lösung für Smartphones: Mit einer theoretischen Übertragungsrate von 7,2 Megabit pro Sekunde können Daten vergleichbar schnell abgerufen werden wie mit den meisten heimischen DSL-Leitungen. Und durch den hohen Integrationsgrad lässt sich die gesamte Modem-Funktionalität auf einer Platinenfläche von gerade einmal 650 Quadratmillimetern unterbringen. Damit bietet Infineon die industrieweit kompakteste und batterieschonendste HSDPA-Lösung. Die ersten Modelle unserer Kunden aus Asien und den USA sind bereits am Markt. Für den noch leistungsfähigeren Nachfolgestandard HSUPA werden wir verschiedene Varianten anbieten (alle in 65-Nanometer-Technologie), um auch im schnell wachsenden Mobilfunksegment der Smartphones alle Kundenwünsche optimal abdecken zu können.

#### **WELTNEUHEITEN BEI HOCHFREQUENZ-TRANSCIVER UND EDGE-PLATTFORM**

Eine wesentliche Komponente dieser Plattformen ist der HF(Hochfrequenz)-Transceiver. Hier haben wir die Erfolgsgeschichte unserer CMOS-basierten HF-Transceiver mit dem SMARTi™ UE fortgeschrieben. Auf 6 mal 6 Quadratmillimetern werden zum ersten Mal alle wesentlichen Mobilfunkstandards unterstützt: GSM, EDGE, HSDPA und HSUPA. Das schafft bislang kein Wettbewerber. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir bereits den Verkauf des einmilliardsten HF-Transceivers feiern.

Im mittleren Segment des Mobiltelefonspektrums hat Infineon erneut eine Weltneuheit präsentiert. Mit dem X-GOLD™206 wurde im Juni-Quartal die weltweit erste Ein-Chip-Lösung für den EDGE-Standard an einen asiatischen Kunden ausgeliefert.

#### **UNGEBROCHENES WACHSTUM IN CHINA UND INDIEN**

Die Zahl der Mobilfunk-Neukunden wird sich allein in Indien im Jahr 2008 auf fast 90 Millionen erhöhen, in China wird mit einem Kundenplus von rund 56 Millionen gerechnet. Schon jetzt ist das Reich der Mitte mit rund 500 Millionen Handy-Nutzern der größte Markt der Welt.

Die interessanten Märkte der wirtschaftlich aufstrebenden Länder wollen wir mit unseren verschiedenen ULC(ultra low cost)/Entry-Plattformen beliefern. Am kostengünstigsten ist der weltweit höchstintegrierte Mobilfunkchip: unser X-GOLD™101. Damit ermöglichen wir unseren Kunden die Produktion der kostengünstigsten Telefone. Die beeindruckende Zahl von bislang 100 Millionen verkauften Ein-Chip-Lösungen spricht für sich.

Und der technische Fortschritt geht weiter. Mit den Ein-Chip-Lösungen X-GOLD™113 und X-GOLD™213 bietet Infineon Kamera-, Radio- und MP3-Funktion sowie in letzterem Chip auch E-Mail- und Internet-Funktion im unteren Preissegment. Damit wird mobiler Internet-Zugang zum ersten Mal für viele Käuferschichten erschwinglich.